



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203120278 U

(45) 授权公告日 2013. 08. 07

(21) 申请号 201220724723. 2

(22) 申请日 2012. 12. 25

(73) 专利权人 常州海弘电子有限公司

地址 213000 江苏省常州市新北区春江镇魏村

(72) 发明人 宦洪波 王国庆 陈定红

(74) 专利代理机构 常州佰业腾飞专利代理事务所 (普通合伙) 32231

代理人 朱小杰

(51) Int. Cl.

H05K 1/02 (2006. 01)

(ESM) 同样的发明创造已同日申请发明专利

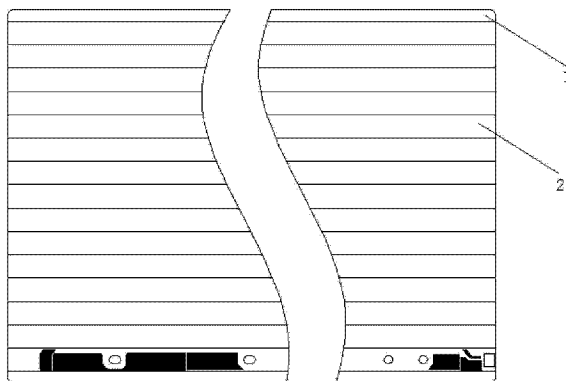
权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 实用新型名称

具有高效率低成本的仿铝基板

(57) 摘要

本实用新型涉及电子设备上常用的 PCB 板, 尤其涉及一种铝基板结构。目的是解决上述存在的问题, 提供一种散热性好具有高效率低成本的仿铝基板。一种具有高效率低成本的仿铝基板, 包括普通层压板和覆铜层。仿铝基板产品大大提高了产品加工效率, 同时很大程度上降低了生产成本。



1. 一种具有高效率低成本的仿铝基板,其特征在于:包括普通层压板(1)和覆铜层(2)。
2. 根据权利要求1所述具有高效率低成本的仿铝基板,其特征在于:所述覆铜层(2)为间隔排列。

具有高效率低成本的仿铝基板

技术领域

[0001] 本实用新型涉及电子设备上常用的 PCB 板,尤其涉及一种铝基板结构。

背景技术

[0002] 随着电子行业的飞速发展,电子产品微型化的趋势日益明显,一块 PCB 板除了固定各种小电子零件外,其主要功能还有提供各种电子零件的相互电气连接。随着信息技术的发展,电子设备也越来越复杂,需要的零件越来越多,PCB 板上的线路与零件也越来越密集。在 PCB 板制造行业中,PCB 板由绝缘隔热、并不易弯曲的材质构成基板,在表面可以看到的细小线路材料是铜箔,原本铜箔是覆盖在整个板上,在制造过程中部分被蚀刻处理掉,留下来的部分就变成网状的细小线路了,这些线路被称作导线,并用于提供 PCB 板上零件的电路连接。

[0003] 为了提高 PCB 板的散热性,行业内开始使用铝基板,但是铝基板材质特殊,在钻孔、外形加工过程中需要特殊钻孔加工处理、且过程较为繁琐,加工成品钻孔需按照特定程序钻咀加工,特别是外形需要特定铣床一条条水铣或者是模具几次冲制方可成型。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的是解决上述存在的问题,提供一种散热性好具有高效率低成本的仿铝基板。

[0005] 本实用新型的目的是以如下方式实现的:

[0006] 一种具有高效率低成本的仿铝基板,包括普通层压板和覆铜层。

[0007] 所述覆铜层为间隔排列。

[0008] 本实用新型将铝基板基材替换为普通材料的层压板,并按其属性将资料重新处理,经过仿照铝基板生产工艺特殊处理,即可将铝基板的成型加工改为普通 PCB 板的加工方式,且产品性能可以满足铝基板性能,仿铝基板产品大大提高了产品加工效率,同时很大程度上降低了生产成本。

附图说明

[0009] 下面根据具体实施例并结合附图,对本实用新型作进一步详细的说明,其中

[0010] 图 1 是本实用新型结构示意图。

具体实施方式

[0011] 见图 1 所示,一种具有高效率低成本的仿铝基板,具有普通层压板 1 和覆铜层 2,所述覆铜层为间隔排列。

[0012] 以上所述的具体实施例,对本实用新型的目的、技术方案和有益效果进行了进一步详细说明,所应理解的是,以上所述仅为本实用新型的具体实施例而已,并不用于限制本实用新型,凡在本实用新型的精神和原则之内,所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包

含在本实用新型的保护范围之内。

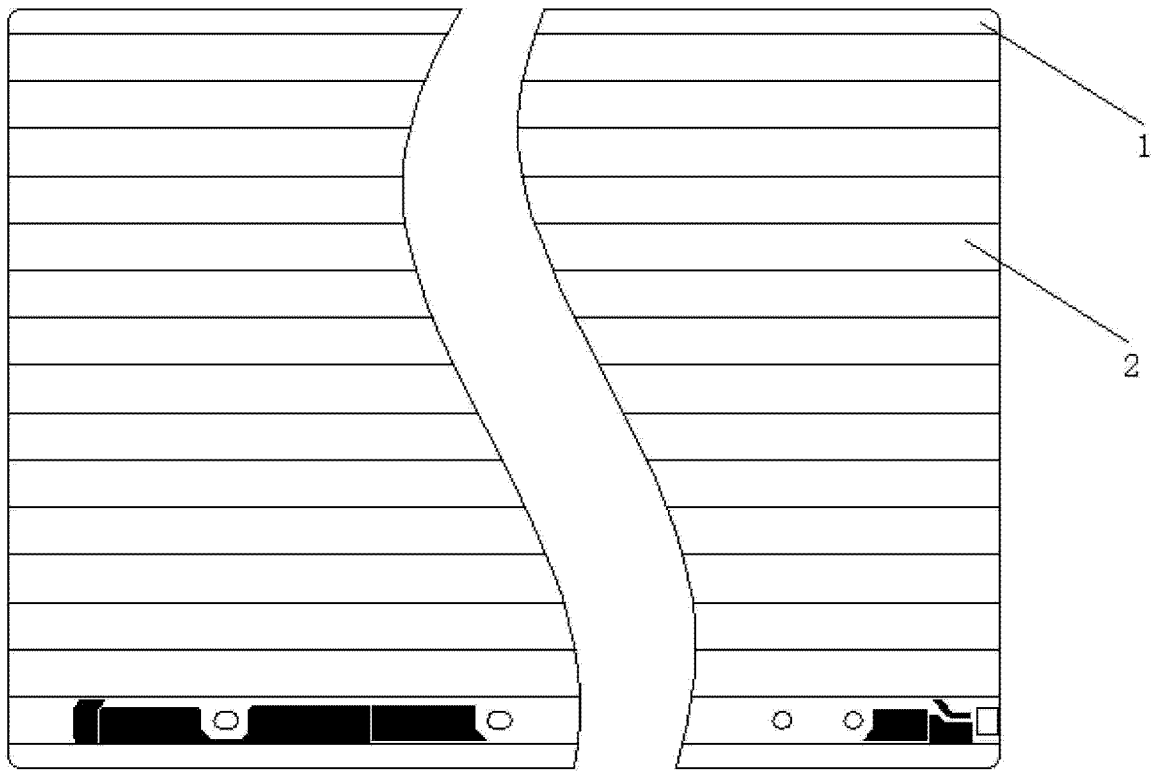


图 1